@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-68609

⊕Int. Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	49公開	平成3年(1991)3月25日
C 08 F 220/26 C 03 C 25/02	MM L	8620-4 J 8821-4 G		
C 08 F 220/22 299/02	MMT B MMV A MRV	8620-4 J 8620-4 J 7445-4 J		
C 09 D 4/00 4/02	PDY PDV	8620-4 J 8620-4 J		
G 02 B 6/44	301 A	7036-2H 審査請求	え 未請求 記	請求項の数 2 (全7頁)

図発明の名称 樹脂組成物及び耐熱性光フアイパ用コーティング剤

②特 願 平1-203796

②出 願 平1(1989)8月8日

⑫発 明 者 横 島 実 茨城県取手市井野2291

⑩発明者松本 第一東京都北区志茂3-17-18

⑪出 願 人 日本化薬株式会社 東京都千代田区富士見1丁目11番2号

個代 理 人 弁理士 竹田 和彦

明 細 舊

1. 発明の名称

樹脂組成物及び耐熱性光ファイバや用コーティング剤

2. 特許請求の範囲

1)エポキシアクリレート(A)と

一般式〔1〕

(但し、式中、 R は、 H 又 は CH : であり、 a 及 び b は、各々、 1 又は 2 である。)

で示される化合物(B)とイミドアクリレート

(c)を含有することを特徴とする樹脂組成物。

2) エポキシアクリレート (A) と

一般式〔1〕

$$CH_{z} = \frac{1}{C} - \frac{1}{C} - 0 - (CH_{z})_{z} + (CF_{z})_{z} + (CH_{z})_{z}$$

$$0 - C - C - CH_{z}$$
(1)

(但し、式中、Rは、H又はCH, であり、a及 び b は、各々、1又は2である。)

で示される化合物 (B) とイミドアクリレート (c) を含有することを特徴とする耐然性光ファイバ用コーティング剤。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、樹脂組成物及び耐熱性光学ガラスファイバー用コーティング剤に関し、特に高温で使用する光ファイバのガラス表面保護に施されるコーティング剤に関する。

(従来の技術)

光ファイバは、情報伝送性能が大であり外部の 干渉を比較的受けないので、最近数年間特に通信 分野において用途が著しく増加している。 光ファイバは、通信分野で使用されるため一般にガラス

製である。しかしガラスファイバは、元来もろく、 水蒸気により化学的におかされるので容易に破壊 され、取り扱いが困難である。従って、従来より、 光学ガラスファイバは、表面に樹脂被覆が筋され ている。この様な樹脂被覆材料としては、従来エ ポキシ樹脂、ウレタン樹脂等が用いられているが、 硬化に長時間を要するので生産性に劣るほか、柔 飲性に欠けるので、側圧により伝送特性が損なわ れる欠点がある。最近上記欠点を改良する目的で カレタンアクリレートを含む紫外線硬化性組成物 がさかんに検討され、光学ガラスファイバ用紫外 線硬化性組成物およびかかる被膜を形成する方法、 例えば、特開昭 5 8 - 2 2 3 6 3 8 号、特開昭 5 9 - 1 7 0 1 5 4 号および特開昭 5 9 - 1 7 0 155号明細書に紫外線硬化性コーティング組成 物が提案されている。

(発明が解決しようとする課題)

現在使用されている紫外線硬化性コーティング 組成物は、速い硬化速度、所望の特性が容易に且 つ正確に得られる利点を有するが、高温での長期 の使用には、硬化物のヤング率、伸び及び強度等の変化が大きく、常時、高温で使用する様な用途、例えば、ミサイルや原子炉等に使用する光ファイバ用コーティング剤には、使用できない。

(課題を解決するための手段)

上記の課題を解決するため、本発明者とは、鋭意研究した結果、硬化速度が速く、硬化して得られた樹脂被膜を、高温下に放置しても、伸びヤング率等の物性の変化が小さく、また吸水率も小っさい光伝送用の光学がラスファイバのコーティング剤に通した新規な樹脂組成物を提供することに成功し、本発明を完成した。すなわち、本発明は、(1)エポキシアクリレート(A)と

一般式〔〕〕

$$CH_{z} = C - C - O - (CH_{\overline{z}}) \cdot (CF_{\overline{z}}) \cdot (CH_{\overline{z}}) \cdot (CH_{\overline{$$

(式(1)中、Rは、H又はCH:であり、a及びbは、各々、1又は2である。)

で示される化合物(B)とイミドアクリレート(c)を含有することを特徴とする樹脂組成物。

(2) エポキシアクリレート (A) と一般式 (I) で示される化合物 (B) とイミドアクリレート (C) を含有することを特徴とする耐熱性 光ファイバ用コーティング 剤に関するものである。

本発明では、エポキシアクリレート(A)を使用するが、その具体例とは、シェル化学(株)製、エポキシ樹脂、エピコート1001、三井石油化学(株)製、エポミックRー114 等)のエポキシアクリレート、ピスフェノールトを関エポキシ樹脂 (例えば、シェル化学 (株) 製、エピコート807 等)のエポキシ 樹脂 (例えば、三井石油化学 (株) 製工ポミック Rー710)のエポキシアクリレート、ピグントインのジグリシジルエーテル (例えば、チバガィギー (株) 製、アラルダイト X B 2793等)

のエポキシアクリレート、環式脂肪族エポキシ (例えば、ダイセル化学工業(株)、セロキサイ ド2021等) のエポキシアクリレート等を挙げる事 ができる。こうしたエポキシアクリレート (A) を得るには、例えば上記に挙げたようなエポキシ 樹脂のエポキシ基に対してアクリル酸を反応せし めることによりエポキシアクリレート(A)を得 ることができる。かかるエポキシ基とアクリル酸 との反応は、例えば、トリエチルアミン、テトラ メチルアンモニウムクロライド、ジメチルベンジ ルアミン、トリメチルペンジルアンモニウムクロ ライド、トリフェニルスチピン等の慣用の触媒を 使用するのが好ましい。この触媒の好ましい使用 量は、反応混合物に対して0.1~5重量%である。 特に好ましいエポキシアクリレートとしては、ビ スフェノールA型エポキシ樹脂のエポキシアクリ レート、ピスフェノールド型エポキシ樹脂のエポ キシアクリレート等が挙げられる。エポキシアク リレート(A)の使用割合は、樹脂組成物及び耐 熱性光ファイバ用コーティング剤中10~60重量%

の範囲で使用するのが好ましく、特に20~50重量 %の範囲で使用するのが好ましい。

本発明では、一般式 (「」で表される化合物 (B)を使用する。化合物 (B)は、

HO - CH = (CF =) - CH = - OH + HO - CH = CH = (CF =) - CH = CH = - QHのフッ素化合物と(メタ)アクリル酸を反応 させることによって得ることができる。 アクリル 酸またはメタクリル酸の使用量は、仕込んだ前記 フッ素化合物0.5 モル当り、それらの約1~5モ ルである。該反応は、(メタ)アクリル二重結合 の重合を最少化または遅延させるために重合防止 剤の存在下に行うことが好ましい。上記重合防止 剤は、当業者に周知なものであり、それらは該混 合物の0.01~5 重量%の濃度で使用する。それら の重合防止剤の例として、ハイドロキノン、P-メトキシフェノール、2,4-ジメチル-6-t-ブチルフェノール、P-ベンゾキノン、フェノチ アジン、 N - ニトロソジフェニルアミン、チオ尿 素、調塩等が挙げられる。核反応は、一般的には 約50℃~130 ℃好ましくは65℃~90℃の温度にお いて、一般式(「)で衷される化合物(B)を生 成するためのアクリル酸または、メタクリル酸に よる前記のファ素化合物のエステル化を確実に完 結させるために十分な時間にわたって行う。この 時間は、バッチの規模、それぞれの反応物及び触 媒及び採用される反応条件により変動する。また エステル化触媒は使用されるアクリル酸又は、メ タクリル酸に対して0.1 ~ 15 モル%、好ましく は、1~6モル%の濃度で存在させる。エステル 化触媒としては任意の公知のものを使用すること かでき、これらの例として、P-トルエンスルホ ン酸、メタンスルホン酸、リン酸、硫酸などを挙 げることができる。またエステル化反応中に生成 した水分の除去を助けるためにヘキサン、シクロ ヘキサン、ベンゼン、トルエンのような不活性溶 剤を存在させることが望ましい。 一般式(1)で 表される化合物 (B) の使用量は、樹脂組成物及 び耐熱性光ファイバ用コーティング剤(これらを 以後組成物という。)中10~80重量%であるのが 好ましく特に30~60重量%であるのが好ましい。

本発明では、イミドでは、イミドでは、イミドでは、クリレート(C)を使用は、イミが、使用して、クリックの対象、は、クリックの対象、ないでは、クリックの対象、ないでは、クリックの対象、大力の対象、大力の対象、大力の対象がある。という、クリックのでは、クリックをあって、クリックをある。

前記のジカルボン酸無水物とヒドロキシアルキルアミン類の反応は、溶媒の存在下、50~200 で、好ましくは80~150 での温度において脱水して行われる。本反応に使用しうる溶媒は、ベンゼン、トルエンレン、シクロヘキサン、(common を分からないがある。反応のである。反応のである。反応の

終了にあたって、ジカルボン酸無水物とヒドロキシアルキルアミン類の反応物を含む反応混合物をそのまま次の反応原料として使用することもできるが、未反応原料を水洗等によって除去して使用することもできる。

イミドアクリレート(C)の製造

 ・ 合防止剤は当業者に周知であり、それらは該混合 物の0.01~5 重量%の濃度で使用するのが好まし い。それら重合防止剤の例として、ハイドロキノ ン、 P - メトキシフェノール、2, 4 - ジメチルー 6-1-ブチルフェノール、P-ベンゾキノン、 フェノチアジン、N-ニトロソジフェニルアミン、 銅塩当が挙げられる。 該反応は、一般的に約50~ 150 ℃、好ましくは80~130 ℃の温度においてイ ミドアクリレートを生成するための、アクリル酸 による前記のジカルボン酸無水物とヒドロキシア ルキルアミン類との反応物のエステル化を確実に 完結させるのに十分な時間にわたって行う。又、 エステル化触媒を、使用されるアクリル酸に対し て0.1~15モル%、好ましくは1~6モル%の濃 度で存在させる。任意の公知のエステル化触媒を 使用することができる。これらの例として、硫酸 P-トルエンスルホン酸、メタンスルホン酸、リ ン酸等を挙げることができる。ペンゼン、トルエ ン、シクロヘキサン等の不活性溶剤を存在させて、 このエステル化反応中に生成した水分の除去を助

けることが望ましい。

特に好ましいイミドアクリレートとしては、無水フタル酸、ヘキサヒドロ無水フクル酸、ケリカルボン酸 無水カタル酸 等のジカルボン酸 無水物と2-アミノー1-エタノール、3-アミン類の反応物とアクリル酸の反応物が挙げられる。イミドアクリレート (C)の使用割合は、粗成物中5~40重量%の範囲で使用するのが好ましい。

本発明の組成物は、紫外線で硬化する場合、光重合開始剤としては、公知のどのような光重合合良的剤であっても良いが、配合後の貯蔵安定性の良い事が要求される。この様な光重合開始剤としてリン、ペンジルジメチルケタール、1-ヒドリオチルベンブイルジフェノイルスルフィーとサイド等が挙げられる。好ましいものとしては、1-ヒドリキシシクロヘキシルフェニルケトン等

本発明の樹脂組成物は、光学ガラスファイバの被覆用に有用である他、ブラスチックの保護コーティング、各種インキ等にも使用できる。

本発明の耐熱性光ファイバ用コーティング剤を 用いて光学ガラスファイバを被覆する場合、コー ティング法としては、ダイスコーティング法が適 当である。

本発明の耐熱性光ファイバ用コーティング 剤を用いて光学ガラスファイ バを被覆する場合、光学ガラス母材を線引きし、これに本発明の耐熱性光ファイバ用コーティング 剤を、好ましくは、20~300 μの厚さで被覆し、紫外線照射により、硬化する。本発明の組成物は、紫外線照射によりで移場に硬化する。例えば、低圧又は、高圧水銀灯、キセノン灯を用い紫外線を照射すればよい。

(実施例)

以下、本発明を製造例及び実施例により具体的に説明する。なお、製造例、実施例中の部は、重量部である。

(エポキシアクリレート (A) の製造例) 製造例 1

エポキシ当量187 のピスフェノールA型エポキシ樹脂 (シェル化学 (株) 製、エピコート828) 959 部、アクリル酸362 部、ジメチルベンジルアミン4.7 部、メトキノン0.7 部を入れ、95℃で15 時間反応を行い酸価1.5mgKOH/gのエポキシアクリレート(A-1)を得た。

製造例 2

,,,

エポキシ当量169 のビスフェノール F 型エポキシ樹脂 (シェル化学 (株) 製、エピコート807)
900 部、アクリル酸376 部、トリフェニルスチビン4.6 部、メトキノン0.6 部を入れ90℃で20時間反応を行い酸価2.1mg K O H/g のエポキシアクリレート (A-2) を得た。

(一般式 (I) で表される化合物 (B) の製造例) 製造例 3

下記構造式の化合物 700部

HOCH . CH . (C . P .) CH . CH . OH

アクリル酸 452 部、硫酸 15部、ハイドロキノン 5部、ベンゼン 480 部、シクロヘキサン 120 部を住込み、加熱し、生成水は、溶剤と共に蒸留、軽縮させ分離器で水のみ系外に取り除き、溶剤は、反応器に戻す。水が 87部生成した時点で冷却した。反応温度は、82~89℃であった。反応混合物をベンゼン1200部及びシクロヘキサン300 部に溶解し、

3 - メチルヘキサヒドロ無水フタル酸168 部、2 - アミノー1 - エタノール87部、トルエン300 部を仕込み、製造例 5 と同様にして、生成水が18 部になった時点で冷却した。次のイドロキノン1 部を仕込み、製造例 5 と同様にして、生成水が18部になった時点で冷却した。反応混合物を水が18部になった。解し、20% 苛性ソーダ水を下ルエン1000部に溶解し、20% 苛性ソーダ水溶液で中和して後、20% 食塩水500 部で3回洗浄する。溶剤を減圧留去して、淡黄色の液体342 部(Cー

20% 苛性ソーダー水溶液で中和した後、20% 食塩水300 部で3回洗浄する。溶剤を波圧留去して淡黄色の液体912 部(B-1)を得た。

製造例 4

下記構造式の化合物 524部

HOCH TC . P T CH TOH

アクリル酸 346部、硫酸11部、ハイドロキノン2部、ベンゼン400 部、シクロヘキサン100 部を仕込み、加熱し、生成水が72部になるまで製造例 3 と同様に反応を行った。反応温度は82~88℃であった。反応混合物をベンゼン1200部及びシクロヘキサン300 部に溶解し、製造例 3 と同様に、中和、洗浄、股溶剤を行い、淡黄色の液体700 部(B-2)を得た。

(イミドアクリレート (C) の製造例) 製造例 5

へキサヒドロ無水フタル酸154 部、2 - アミノ - 1 - エタノール88.7部、トルエン300 部を仕込み、加熱し、生成水は、溶剤と共に蒸留、凝縮させ、分離器で水のみ系外に取り除き、溶剤は、反

2) を得た。

製造例 7

無水フタル酸148 部、 3 - アミノー1 - ブタクール89部、トルエン400 部を仕込み、連例 5 と同様にして生成水が18部になった時にエンスの治力により、アクリル酸86部、P-トルエンスの治力により、18部になった時間により、生成水が18部になった時間により、1000部に溶解した。20% 音性ソーダ水溶液で中和した後、Eの流体が18部では、20% 食塩水 で中和した後、Eの液体234 部(C-3)を得た。

〔樹脂組成物の実施例〕

実施例 1

製造例 1 で得たエポキシアクリレート(A-1)30部、製造例 3 で得た一般式〔Ⅰ〕 で表される化合物(B-1)50部、製造例 5 で得たイミドアクリレート(C-1)20部及び1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン(チバ・ガイギー(株)製、イルガキュアー184)3 部、を混合し、樹脂組

成物Aを調製した。

硬化物の特性を第1表に示す。

実施例 2

製造例 1 で得たエボキシアクリレート(A - 1)35 部、製造例 3 で得た一般式(1)で表される化合物(B - 1)40 部、製造例 6 で得たイミドアクリレート(C - 2)15 部、ヒドロキシピバリン酸ネオベンチルグリコールの 4 モルεーカブロラクトン反応物のジアクリレート(日本化薬(株)製KAYARADHX-620)10 部及び 1 - ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン 3 部を混合し、樹脂組成物Bを調製した。

硬化物の特性を第1妻に示す。

実施例3

製造例 2 で得たエボキシアクリレート(A - 2)40 部、製造例 4 で得た一般式 (I) で表される化合物 (B - 2) 40 部、製造例 5 で得たイミドアクリレート (C - 1) 10 部、アダマンチルアクリレート10 部及び 1 - ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン 3 部を混合し、樹脂組成物 C を調製し

た。 .

硬化物の特性を第1表に示す。

実施例 4

製造例 2 で得たエポキシアクリレート(A - 2)20 部、製造例 3 で得た一般式(I)で表される化合物(B - 1)50 部、製造例 7 で得たイミドアクリレート (C - 3) 10 部、トリス(2 - ヒドロキシエチル)イソシアヌル酸トリアクリレート20 部及び1-ヒドロトシクロヘキシルフェニルケトン3 部を混合し、樹脂組成物 D を調製した。硬化物の特性を第 1 表に示す。

第 1 麦

	樹	脂	組成	物
	A	В	С	D
硬度(ショアD)	6 9	7 2	75	77
ヤング字 (23℃,kg/==*)	117	115	120	1 2 5
破断伸度 (23℃、%)	6.0	9.0	5.5	5.0
破斯強度(23℃, kg/mm²)	4.5	4.6	4.8	5.0
150 で/1ヶ月放置後の ヤング率、破断伸度				
ヤング率(23℃, kg/mm²)	1 1 8	116	121	126
破断伸度 (23℃, %)	6.5	9.1	5.4	4.9
吸水平(重量增加%)	1.1	1.3	1.4	1.3

上記第1表において、

【ショア硬度 D 】の測定: A 、 B 、 C 及び D の組成物は、 高圧水銀ランプ (ランプ出力 2 K w)を平行に配した光源下 8 cm の位置で照射して (コンペアスピード 20 m / m in)厚さ 250 μ m のシートを作製し、これを用いて測定した。測定法は JIS-2 2246の方法に単じて行った。

(破断強度:kg/mm*、破断伸度:%、ヤング率:kg/mm*)の測定:試験は、上記のショア硬度 Dの測定に使用したものと同一の条件で作製したシートを用いて測定を行った。

【吸水率】の測定: 試験片は、上記のショア硬度 Dの測定に使用したものと同一の条件で作製した。これを用いて、 純水中に20℃/24 時間浸せ きして試験の前・後の重量を測定し、吸水による重量の増加を%で表した。

実施例 5

・光学ガラスファイバ用母材を約2000℃に加熱し、 5 m/秒の速度で外径125 ミクロンの光学ガラスファイバに紡糸した。連続する次の工程で、ダイス コーティング法により、実施例1~4の樹脂組成物A~Dを被覆し紫外線を照射して硬化した。得られた被覆光学ガラスファイバは、樹脂組成物A~Dのいずれを被覆した場合も、150 ℃に1ケ月放置しても伝送損失の変化は、認められなかった。(発明の効果)

本発明の樹脂組成物及び耐熱性光ファイバ用コーティング剤は、硬化速度が速く、硬化して得られた樹脂被膜は、長期間、高温下に放置した時にも、伸びやヤング率の変化が小さく、着色が少な、 く、従って、高温で使用する光伝送用の光学ガラスファイバのコーティングに特に適する。

特許出願人 日本化棄株式会社